

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 关于为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示：

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行申请融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保基本情况

为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市好顺半导体科技有限公司（以下简称“好顺半导体”）向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“工商银行”）申请循环借款额度人民币 800 万元，公司以坐落于深圳市福田区部分不动产为该笔借款提供抵押担保。

##### （二）审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日和 2025 年 5 月 21 日分别召开了公司第六届董事会第二十六次会议及 2024 年度股东会，会议审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2024 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2025 年担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5 亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 10 亿元（含本数）。有效期自公司 2024 年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会审议相同议案时止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

本次授信及担保事项在 2024 年度股东会审议通过的 2025 年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东会审议。

## 二、担保进展情况

目前好顺半导体已与工商银行签订了《网贷通循环借款合同》及《总授信融资合同》，公司与工商银行签订了《最高额抵押合同》。截至目前，公司上述不动产抵押手续正在办理中；好顺半导体本次计划提款 800 万元，目前尚未放款，后续好顺半导体将在以上借款额度及担保范围内向银行申请融资款项。

## 三、担保协议的主要内容

《最高额抵押合同》内容如下：

- 1、抵押人：新亚制程（浙江）股份有限公司
- 2、抵押权人：中国工商银行股份有限公司深圳上步支行
- 3、债务人：深圳市好顺半导体科技有限公司
- 4、被担保的主债权：自 2026 年 1 月 16 日至 2029 年 2 月 28 日期间，工商银行与债务人签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同等
- 5、被担保的主债权最高额：人民币 16,034,128 元
- 6、抵押物：坐落于深圳市福田区部分不动产

## 四、被担保方的基本情况

公司名称：深圳市好顺半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91440300748878737W

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：忻黎鸣

注册地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 303B

经营范围：一般经营项目：半导体技术研发；电子工具、仪器仪表设备、电子元器件的设计、研发及销售；化工产品（不含危险化学品）的销售及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。有色金属合

金销售；常用有色金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件的生产制造。

与公司关系：系公司的全资子公司

最近一年又一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，好顺半导体资产总额为 101,921,155.30 元，净资产为 35,724,686.85 元，2024 年营业收入为 19,021,268.70 元，净利润为 2,584,942.53 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，好顺半导体资产总额为 71,900,206.03 元，净资产为 36,088,377.71 元，2025 年 1-6 月营业收入为 399,500.24 元，净利润为 363,690.86 元。

以上财务数据中，2024 年 12 月 31 日、2024 年度数据已经审计，2025 年 6 月 30 日、2025 年 1-6 月数据未经审计。

经查询，好顺半导体非失信被执行人。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告落款日，公司经审议的有效对外担保额度为 15 亿元，对外担保总余额为 52,775.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 42.05%；除此之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

## **六、对公司的影响**

本次为子公司向银行申请融资提供抵押担保，有利于满足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该担保事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

## **七、备查文件**

- 1、《网贷循环借款合同》；
- 2、《总授信融资合同》；
- 3、《最高额抵押合同》。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日